

深圳市英唐智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参会单位人员及名单	浙商证券（刘雯蜀、郑毅）、东方财富（向心韵）
时间	2026年3月6日 10:00-11:00
地点	公司会议室
接待人员姓名	英唐智控董事会秘书：李昊先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、基本情况介绍</p> <p>公司董事会秘书李昊先生介绍了英唐智控的发展历程及发展现状，英唐智控深耕电子元器件分销，积累了丰富的客户资源。自研芯片聚焦MEMS微振镜与车载显示芯片，通过加大研发投入、引进高端人才实现技术突破。</p> <p>公司已在多家头部屏厂成功导入车载显示芯片业务，首款车规级TDDI/DDIC的量产落地，多款改进型产品也在按计划推进流片、试产中。公司在MEMS领域具有专业的技术实力和市场竞争力，公司已拥有MEMS器件级别以及LBS（基于激光束扫描的投影方案）全套系统开发能力，且自有的MEMS器件自动化生产线已经实现了量产。公司与欧摩威汽车电子（长春）有限公司签署了《战略合作框架协议》，该协议主要涉及LBS车载智能光应用商业化落地和未来发展，欧摩威将其LBS项目的MEMS芯片的定制开发以及模组生产等工作交由公司完成，旨在加速LBS投影技术从研发向车规级商业化落地的跨越，并推动智能汽车光学交互场景的规模化应用。</p> <p>同时，公司董事会秘书李昊先生就重组方案的具体进展，也做了详细介绍。</p>

二、提问交流环节

1. 公司MEMS LBS车载投影方案是与汽车Tier 1厂商合作还是与车厂直接合作？

答：两种合作模式都有。公司为Tier 1厂商欧摩威提供MEMS LBS模组，Tier1 厂商与多家车厂就该LBS彩色投影技术进行交流，客户均表现出浓厚兴趣。公司也在推进与汽车厂商的直接对接项目，部分汽车厂商已开始在相关车型上对公司的方案进行测试。

2. 光隆集成的主要客户群体是哪些？目前量产的如OCS相关产品价格趋势如何？

答：光隆集成的客户涵盖传统光模块厂商、光通信设备厂商、电信运营商以及系统级供应商等，这些需求主要源于光模块产能的扩张所带来的测试环境建设需求以及高速数据中心的建设。为实现更高速的增长，积极开拓海外市场将是必要举措，公司将通过自身的海外客户资源以及制造平台为光隆集成拓展海外市场进行赋能。随着未来产能规模的扩大带来的成本下降，产品价格也将有调整的空间。

3. 光隆集成的OCS业务占比多少？未来希望发展到什么程度？

答：重组草案所披露的营业数据中，光隆集成的主要业务仍然来自于传统的光开关业务，OCS业务的营收占比尚处于逐步提升阶段。公司对OCS业务的未来发展充满信心，随着市场需求的持续释放，公司希望OCS业务能在全球相关市场需求占据一定份额，当然，目标的实现需要一定的时间积累和市场拓展。

4. 光隆集成的核心团队来源？

答：光隆集成的核心团队来自桂林的国家级科研院所，光隆集成始终专注于光开关相关技术研发，在机械式、MEMS微机械式、磁光式、电光式及波导式等多种控制方式上均有长期布局。

5. 重组方案如本年度内能顺利实施，对公司带来的业绩影响有多大？

答：重组事项对公司本年度全年业绩的直接贡献将根据重组审核进展及标的公司的全年业绩实现情况才能最终确定。公司将继续聚焦主营业务发展，持续推进芯片设计等核心业务的研发，为长期发展奠定坚实基础。随着 MEMS LBS 项目等新业务的逐步落地及业绩释放，叠加并购标的未来年度业绩的完

	<p>整并入，公司长期发展潜力值得期待。</p> <p>5. 重组方案目前进展如何？</p> <p>答：公司已于2026年1月29日审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等议案，具体方案已在交易草案中明确，除本次交易草案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公司正按照相关法律法规和交易方案推进收购事宜，待相关工作完成后，公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知。</p> <p>6. 公司是否会做股权激励计划？</p> <p>答：公司高度重视核心团队的稳定与激励，始终认为核心人才是公司长期发展的关键。未来，公司将结合二级市场环境、年度经营发展目标等综合因素，积极研究并择机推出符合公司实际情况的股权激励计划，以进一步将核心团队利益与公司长远发展深度绑定，促进公司持续健康发展。</p> <p>7. 近期，公司业务是否受到地缘政治变化的影响？</p> <p>答：公司主营业务为电子元器件分销，芯片设计制造及软件研发销售等业务。包括MEMS微振镜、车载显示芯片（DDIC/TDDI）等核心产品的研发生产，以及电子元器件分销行业的技术支持服务。目前核心业务及主要市场暂不涉及中东地区。针对海外业务，公司设有相应的海外运营平台和多元化的供应链布局，已建立了较为完善的全球化运营体系和风险应对机制，能够更灵活地调配资源、降低潜在风险，保障公司海外业务的持续稳定运营。</p>
<p>风险提示</p>	<p>公司发行股份及支付现金购买资产事项涉及向深交所、中国证监会等相关监管机构的申请审核注册工作，上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。除此之外，本次交易存在被暂停、中止或取消的风险。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单</p>	
<p>日期</p>	<p>2026年3月6日</p>